

INFRARED IC HEATER

智能回流焊机

用户使用手册

型号: **T-962C**



一、概述:

本产品采用微电脑控制, 可满足不同的 SMD、BGA 焊接要求, 整个焊接过程自动完成, 操作简单;

采用快速红外线辐射和循环风加热, 温度更加准确、均匀。

模糊控温技术和可视化抽屉式工作台, 使整个焊接过程在你的监视下自动完成; 能完成单、双面板的焊接; 可焊接最精细表贴元器件。

采用了免维护高可靠性设计, 让你用的称心、放心。

二、产品说明:

1、超大容积回焊区:

料抽尺寸达: **600 x 400 mm**, 大大增加本机的使用范围, 节省投资。

2、多温度曲线选择:

内存八种温度参数曲线可供选择, 并设有手动加热、强制冷却等功能; 整个焊接过程自动完成, 操作简单。

3、独特的温升和均温设计:

输出功率达 **2500W** 的快速红外线加热和均温风机配合, 使温度更加准确、均匀, 可以按你预设的温度曲线自动、准确完成整个生产过程, 无须你额外控制。

4、人性化的科技精品:

刚毅的外观, 可视化的操作, 友好的人机操作界面, 完美的温度曲线方案, 从始至终体现科技为本; 轻巧的体积和重量, 让你节约大量金钱; 台面式放置模式, 可让你拥有更大的空间; 简单的操作说明, 让你一看就会。

5、完善的功能选择:

回焊、烘干、保温、定型、快速冷却等功能集于一身; 可完成 CHIP、SOP、PLCC、QFP、BGA 等所有封装形式的单、双面 PCB 板焊接; 可用作产品的胶固化, 电路板热老化, PCB 板维修等多种工作。广泛适用于各类企业、公司、院所研发及小批量生产需要。

6、技术参数:

料抽尺寸: 60 x 40 cm

产品外型尺寸: 68.4 x 50.4 x 22.5 cm

额定功率: 2500W

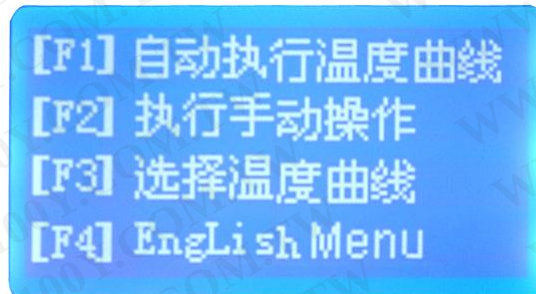
工艺周期: 1~8 min

电源电压: AC110V~AC220V/50~60HZ

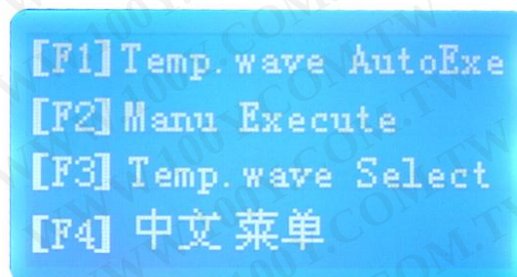
三、操作说明:

1、设备安装调试与操作:

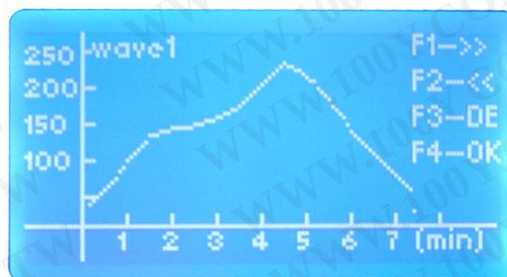
将本机放置在通风的平台上, 周围不能有可燃物品, 抽屉向外放置, 预留抽屉开合的空间, 方便操作; 机体四边要求预留 20mm 的散热空间, 保证底部通风流畅; 接上电源, 开启电源开关, 前面板液晶屏初始显示主操作界面:



按 F4 键, 切换为英语文件菜单 (English Menu)



在主界面下, 按 F3 键选取不同的温度曲线: 如曲线 1



再按 F3 键, 显示曲线的关键参数: 适宜锡浆的种类, 回焊的温度、时间等, 如下图



按 F4 键返回上一个页面，按 F1 键自动执行选定的温度曲线，工作结束后，自动停机，蜂鸣器报警。

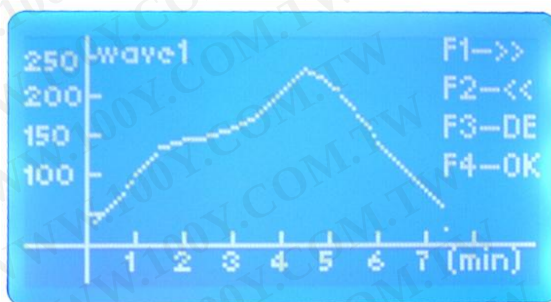
在主面板下，按 F2 键选取手动操作：



按 F1 键，启动冷却风机，再按 F1/S 键停止；按 F2 键，启动电热，再按 F2/S 键停止。

2、曲线选择：

1)、开机后，按 S 键选取操作界面，按 F4 键选取不同的语言类别，按 F3 键 进入温度选取界面：



2)、根据你的加工要求选取不同的曲线。按 F1/F2 键，向前/向后选取不同的温度曲线，有 8 种不同的温度曲线可供你选择，按 F3 键查看不同的曲线参数，按 F4 键确认曲线，返回主操作界面。

曲线 1，适用于： 85Sn/15Pb 70Sn/30Pb；

曲线 2，适用于： 63Sn/37Pb 60Sn/40Pb；

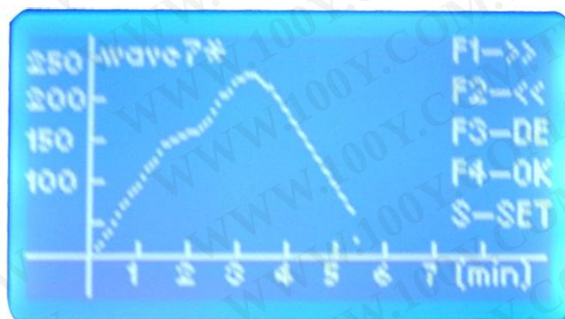
曲线 3，适用于： Sn/Ag3.5； Sn/Cu.75 Sn/Ag4.0/Cu.5

曲线 4，适用于： Sn/Ag2.5/Cu.8/Sb.5； Sn/Bi3.0/Ag3.0

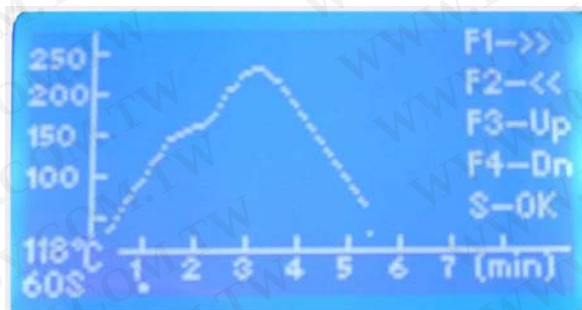
曲线 5，适用于： 红胶标准固化温度曲线，Heraeus PD955M

曲线 6，适用于： PCB 板返修等

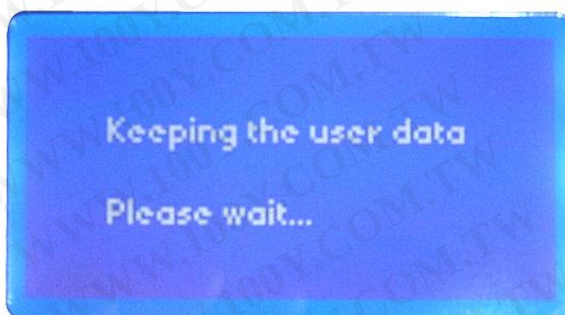
曲线 7，8，适用于： 用户自设定曲线：



按 S 键进入温度设定界面:



按 F1/F2 键, 向前/向后选取不同的时间点, 按 F3/F4 键, 向上/向下选取不同的温度点, 选择多点连成相应的曲线, 按 S 键保存:



保存完后, 自动返回, 如用户满意可以按 F4 键选取; 如用户不满意, 再按 S 键重复上边的操作即可。

3、操作说明:

- 1)、轻轻将要加工的物品放入抽屉内的平台上, 关上抽屉, 按 F1 键开机, 自动执行选定的加温曲线; 液晶屏上显示当前的执行时间、设定温度、测量温度, 并自动记录实际的温度曲线, 供用户比较。
- 2)、通过抽屉前观察窗和液晶屏显示的数据、曲线, 整个加工过程全在你可视的监控中完成, 如果加工曲线达不到你的要求可修改参数。
- 3)、加工曲线是严格按不同的锡浆对回流焊不同的温度要求预设的, 你可根据不同的需求预设另外的温度曲线。
- 4)、加工过程中, 如须停止, 可按 S 键进行强制终止; 加工完成后, 风机自动对产品进

行冷却；你也可强制启动风机进行冷却。

5)、回焊完成后，如果产品存在缺陷的话，可再重自动焊一遍，也可手动启动加热进行回焊。

4、特别提醒：

1)、本机为满足无铅双面焊接，设计有独特的风道，焊接时 PCB 板的上面和下面温度差异较大的，可保证焊上面的元件时，下面的贴片不脱落；为保证小板的焊接要求，建议焊接小板和 BGA 植锡球时，在料抽底部预放一块 10x10cm 的 PCB 板，可以使焊接质量更好。

2)、环境温度较低、潮气或湿度太大时，建议焊接前要预热一下机器。操作方法是：选好焊接曲线后，空机自动回焊一次。

3)、本机不能焊接反光性太强的金属封装芯片和金属屏蔽罩；不可以焊接承受温度低于 250 度的塑料插件和物品，敬请注意！

4)、客户检测机器温度的方法：采用标准温度计，将外置温度探头固定在 10x10cm 的 PCB 板正面，一定要紧密贴在 PCB 板的正上面啊！将固定有测温探头的 PCB 板，放入料抽，推入机器内，这样测试的温度比较符合产品生产实际情况。

5、日常养护：

1)、保持腔内清洁：

我们设有**内腔清洁功能**：用过几次之后，建议你手动开启加热和风机 2-3 分钟，让腔内残存的溶剂、焊料加热挥发掉，保证内腔清洁，和整机性能稳定；每停机前一定要开启风机让整机充分冷却后，再关机，这样可延长使用寿命。

2)、定期清洁抽屉的观察孔玻璃，保持其清洁。

四、注意事项

1)、本机电源应可靠接地；长期不用时，应拔掉电源插线。

2)、本机不设排烟通道，建议按放在通风的地方，防止锡浆挥发物中毒。

3)、本机保温材料已经进行严格防护处理，未做防护不得随意拆机。